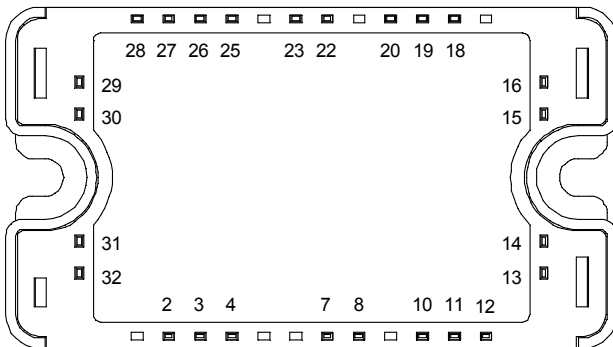
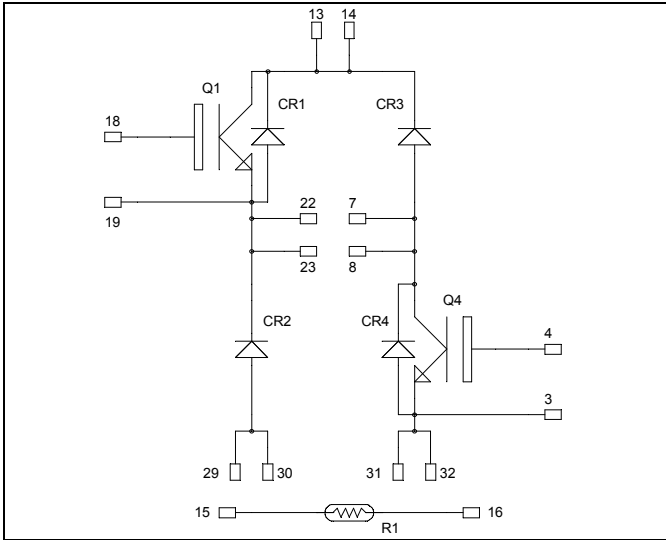


**Asymmetrical - Bridge  
Fast Trench + Field Stop IGBT  
Power Module**

**$V_{CES} = 1200V$   
 $I_C = 75A @ T_c = 80^\circ C$**



All multiple inputs and outputs must be shorted together  
 Example: 13/14 ; 29/30 ; 22/23 ...

### Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Switched Reluctance Motor Drives

### Features

- Fast Trench + Field Stop IGBT Technology
  - Low voltage drop
  - Low tail current
  - Switching frequency up to 20 kHz
  - Soft recovery parallel diodes
  - Low diode VF
  - Low leakage current
  - RBSOA and SCSOA rated

- Kelvin emitter for easy drive
- Very low stray inductance
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

### Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- Easy paralleling due to positive  $T_c$  of  $V_{CEsat}$
- RoHS Compliant

### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
$V_{CES}$	Collector - Emitter Breakdown Voltage	1200	V
$I_C$	Continuous Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	110
		$T_c = 80^\circ C$	75
$I_{CM}$	Pulsed Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	175
$V_{GE}$	Gate - Emitter Voltage	$\pm 20$	V
$P_D$	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	357
RBSOA	Reverse Bias Safe Operating Area	$T_j = 125^\circ C$	150A @ 1150V

**CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

All ratings @  $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified

**Electrical Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_{CES}$	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0\text{V}, V_{CE} = 1200\text{V}$			250	$\mu\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	Collector Emitter saturation Voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 75\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	1.4 2.0	2.1	V
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 3\text{mA}$	5.0		6.5	V
$I_{GES}$	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$			400	nA

**Dynamic Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$C_{ies}$	Input Capacitance	$V_{GE} = 0\text{V}$		5340		pF
$C_{oes}$	Output Capacitance	$V_{CE} = 25\text{V}$		280		
$C_{res}$	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		240		
$Q_G$	Gate charge	$V_{GE} = \pm 15\text{V}, I_C = 75\text{A}$ $V_{CE} = 600\text{V}$		0.7		$\mu\text{C}$
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching ( $25^\circ\text{C}$ ) $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$ $I_C = 75\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$		260		ns
$T_r$	Rise Time			30		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			420		
$T_f$	Fall Time			70		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching ( $125^\circ\text{C}$ ) $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$ $I_C = 75\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$		285		ns
$T_r$	Rise Time			50		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			520		
$T_f$	Fall Time			90		
$E_{on}$	Turn-on Switching Energy	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	7		mJ
$E_{off}$	Turn-off Switching Energy	$I_C = 75\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	8.1		
$I_{sc}$	Short Circuit data	$V_{GE} \leq 15\text{V}; V_{Bus} = 900\text{V}$ $t_p \leq 10\mu\text{s}; T_j = 125^\circ\text{C}$		300		A

**Diode ratings and characteristics (CR2 & CR3)**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		1200			V
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 1200\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		250 500	$\mu\text{A}$
$I_F$	DC Forward Current		$T_c = 80^\circ\text{C}$	75		A
$V_F$	Diode Forward Voltage	$I_F = 75\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	1.6 1.6	2.1	V
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 75\text{A}$ $V_R = 600\text{V}$ $di/dt = 2000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	170 280		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	7 14		$\mu\text{C}$
$E_r$	Reverse Recovery Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	3 5.5		mJ

CR1 &amp; CR4 are IGBT protection diodes only

## Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit	
R <sub>thJC</sub>	Junction to Case Thermal Resistance	IGBT		0.35	°C/W	
		Diode		0.58		
V <sub>ISOL</sub>	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, I <sub>isol</sub> <1mA, 50/60Hz	2500			V	
T <sub>J</sub>	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range	-40		125		
T <sub>C</sub>	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To Heatsink	M5	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				110	g

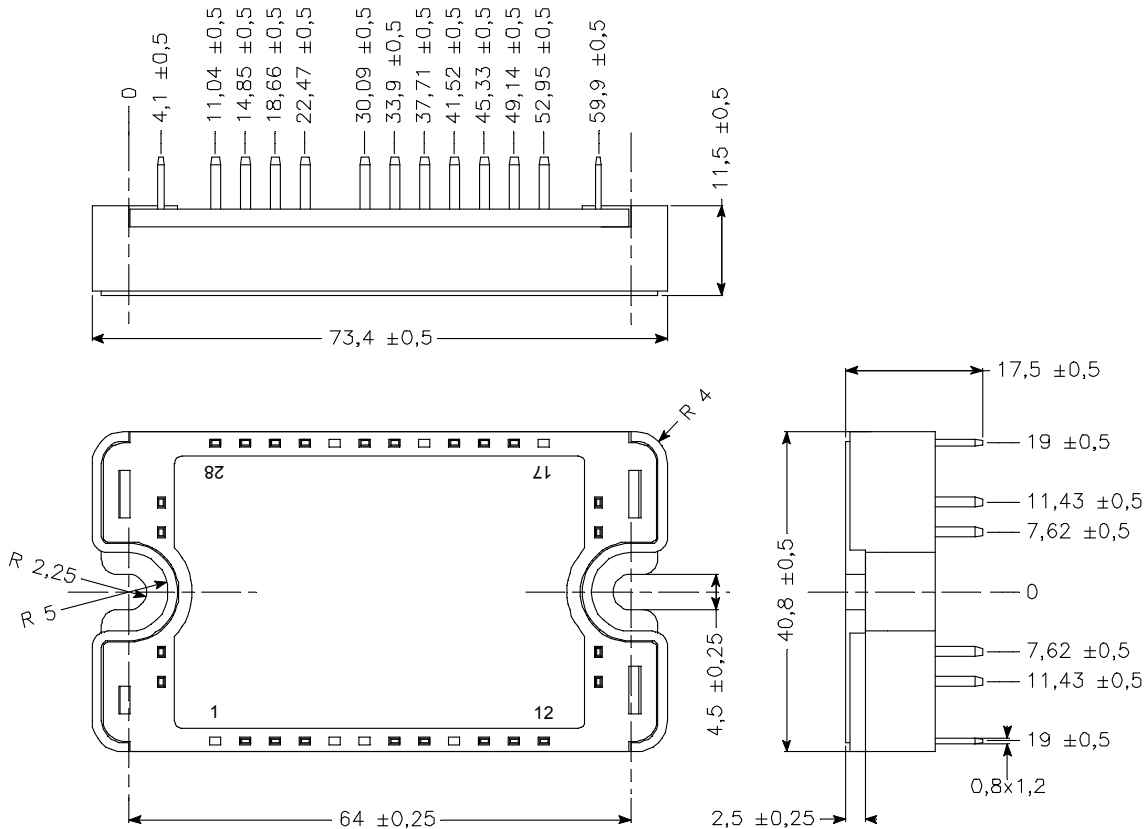
## Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R <sub>25</sub>	Resistance @ 25°C		50		kΩ
ΔR <sub>25</sub> /R <sub>25</sub>			5		%
B <sub>25/85</sub>	T <sub>25</sub> = 298.15 K		3952		K
ΔB/B	T <sub>C</sub> = 100°C		4		%

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp \left[ B_{25/85} \left( \frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]}$$

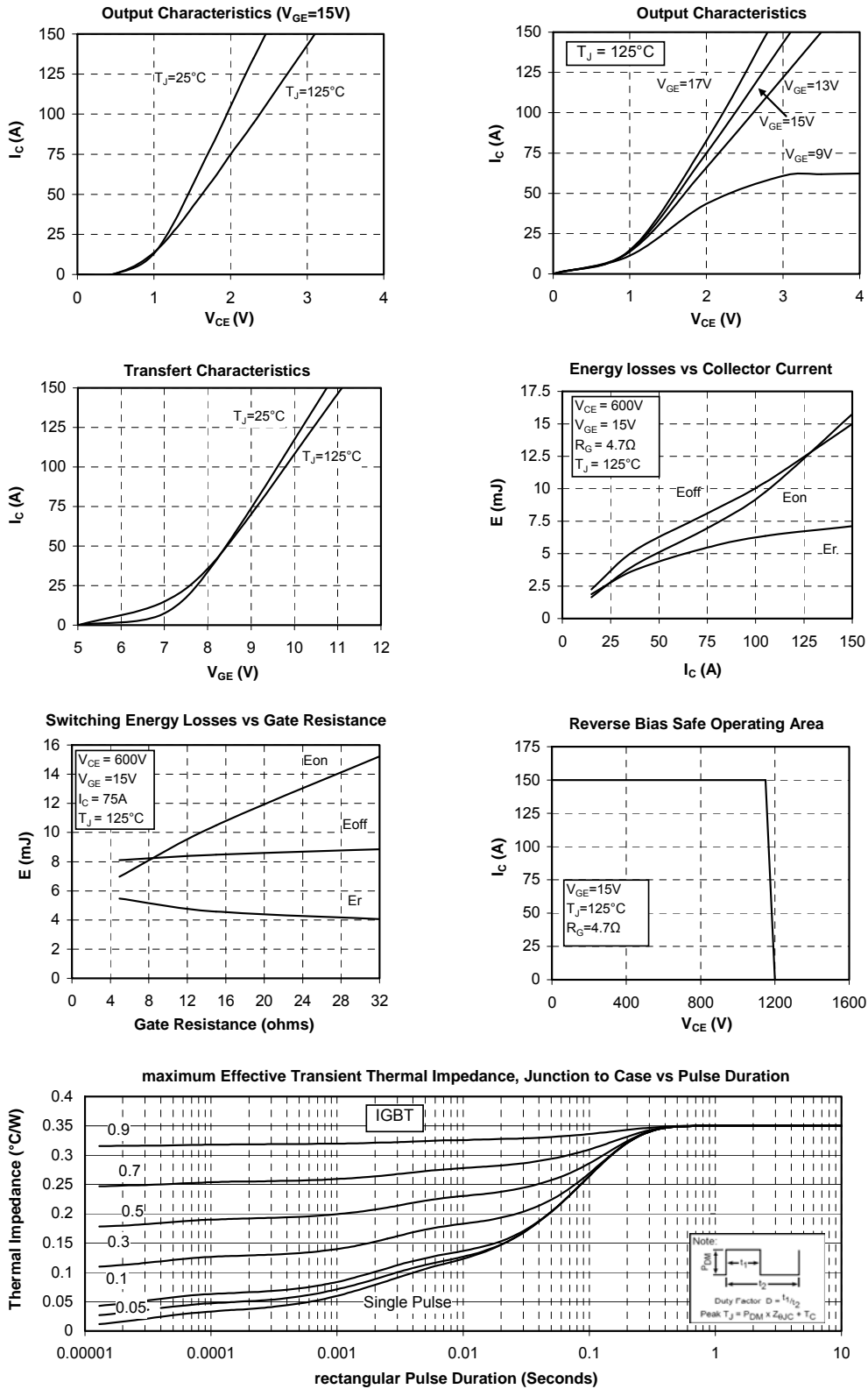
T: Thermistor temperature  
 R<sub>T</sub>: Thermistor value at T

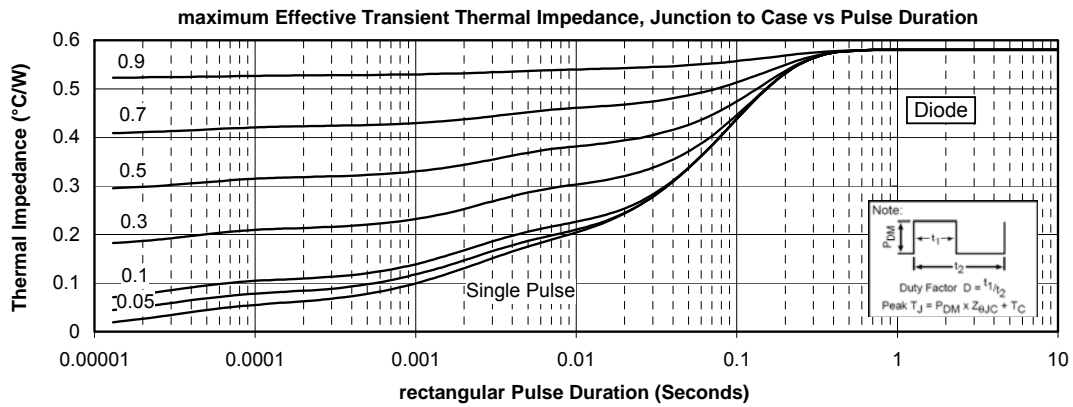
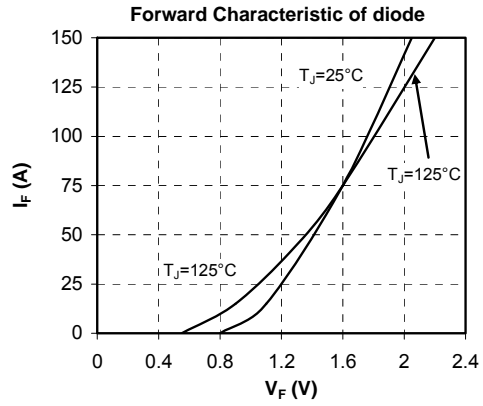
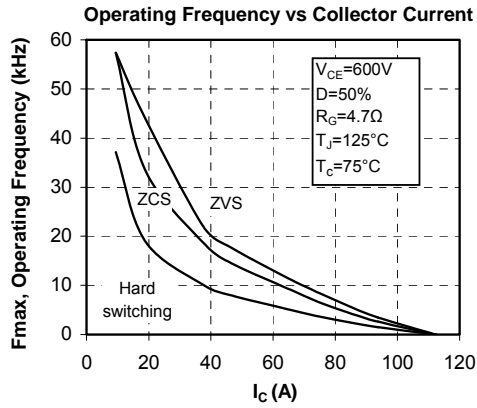
## SP3 Package outline (dimensions in mm)



See application note 1901 - Mounting Instructions for SP3 Power Modules on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

## Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)